

# 東京IPO

## 個人投資家向けオンラインセミナー

2022年3月12日（土）

インスペック株式会社



(証券コード：6656)

- 中国案件の期ズレにより、売上高が当初計画を下回る。
- 2022年1月、大型受注獲得（6.1億円）→翌期以降に納入

## ■ 損益計算書サマリー

(単位：百万円)

	2022年4月期 第3四半期	2021年4月期 第3四半期（連結）	前期比	増減率
売上高	<b>1,207</b>	1,245	△38	△3.1%
営業利益又は 営業損失（△）	△54	△272	218	—
経常利益又は 経常損失（△）	△67	△238	171	—
当期純利益又は 当期純損失（△）	△67	△862	795	—

※ 連結除外に伴い、2021年4月期期末より非連結決算へ移行したため、前期比較は参考値となります。

# 2022年4月期 通期業績予想

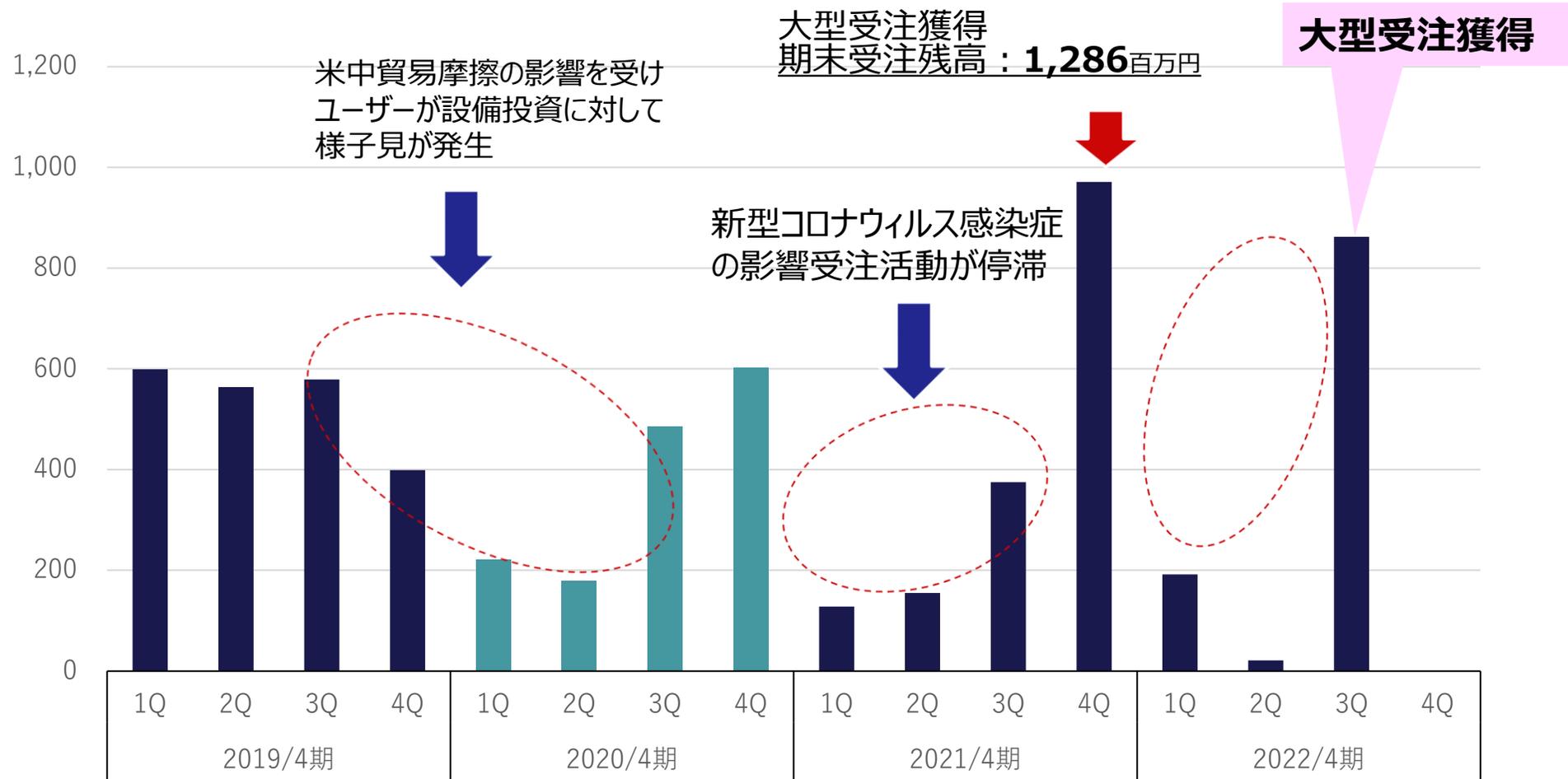
- 中国案件の期ズレにより、売上高が大幅未達
- 国内は商談が活発化しており、大型案件が来期に売上計上予定

(単位：百万円)

	2022年4月期予想	2021年4月期実績	前期比	増減率
売上高	1,750	1,273	477	37.4%
営業利益又は 営業損失 (△)	17	△277	294	—
経常利益又は 経常損失 (△)	120	△310	430	—
当期純利益又は 当期純損失 (△)	100	△1,195	1,295	—

# 受注高推移

(単位：百万円)



**1.インスペックのご紹介**

**2.インスペックの成長戦略**

**3.Appendix（補足資料）**

**用語集**

**2022年4月期第3四半期決算概要**

A modern, multi-story office building with a white facade and large glass windows. The building is set against a clear blue sky. The word "INSPEC" is prominently displayed in blue, 3D-style lettering on the upper left corner of the building's facade. A white banner with blue Japanese text is overlaid on the right side of the image. The building has a clean, industrial aesthetic with dark window frames and a series of small, white, cylindrical light fixtures along the side.

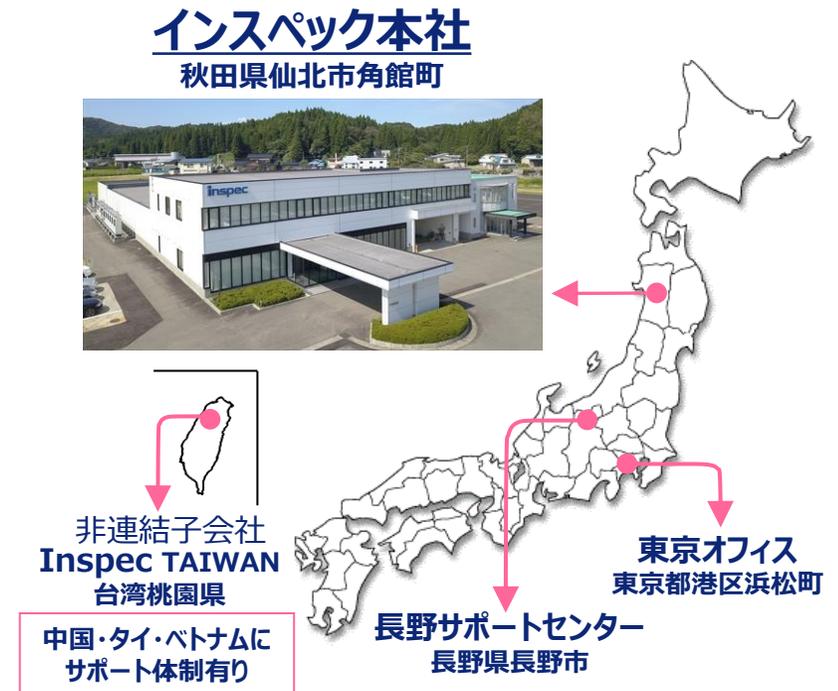
**INSPEC**

**インスペックのご紹介**

# 会社概要 (2022年1月31日現在)



商号	インスペック株式会社
本社	秋田県仙北市角館町雲然荒屋敷79-1
創業	1984年(昭和59年)1月
上場市場	東京証券取引所市場第二部
代表者	代表取締役社長 菅原 雅史
主な事業	電子回路基板(半導体パッケージ基板・FPC等)の外観検査装置及び製造装置の開発・製造・販売・サービス
従業員	73名
資本金	677百万円
発行済株式数	3,790,400 (単元株数:100株)
株主数	5,404名 (2021年10月31日現在)



角館の四季

# インスペックの歴史

## 20th Century

## 21st Century



昭和59年  
太洋製作所創業

昭和63年  
(有)太洋製作所設立

平成3年  
新社屋建設

1984

カセットテープ  
レコーダー向け  
磁気ヘッド  
組み立て

1988

ハンディカムの  
磁気ヘッド  
組み立て

1991

FAシステムの  
設計製造受託開始



1997

検査装置第1号  
リードフレーム検査装置  
MV7000発表



2000

第2世代  
リードフレーム検査装置  
LF2000発表  
ロングセラ—製品



2001年1月1日  
インスペック株式会社に社名変更

2001

BGA検査装置  
BF8000発表  
ロングセラ—製品



2002

2003

COF検査装置  
TR3000発表  
シェアトップとなる



2006

ハイエンドPKG基板AOI  
SX5000発表  
CPU向けPKGに対応



2012

FPC向けロールtoロールAOI  
RA7000発表



2016

2017

平成29年  
東京証券取引所  
市場第二部へ市場変更

2019

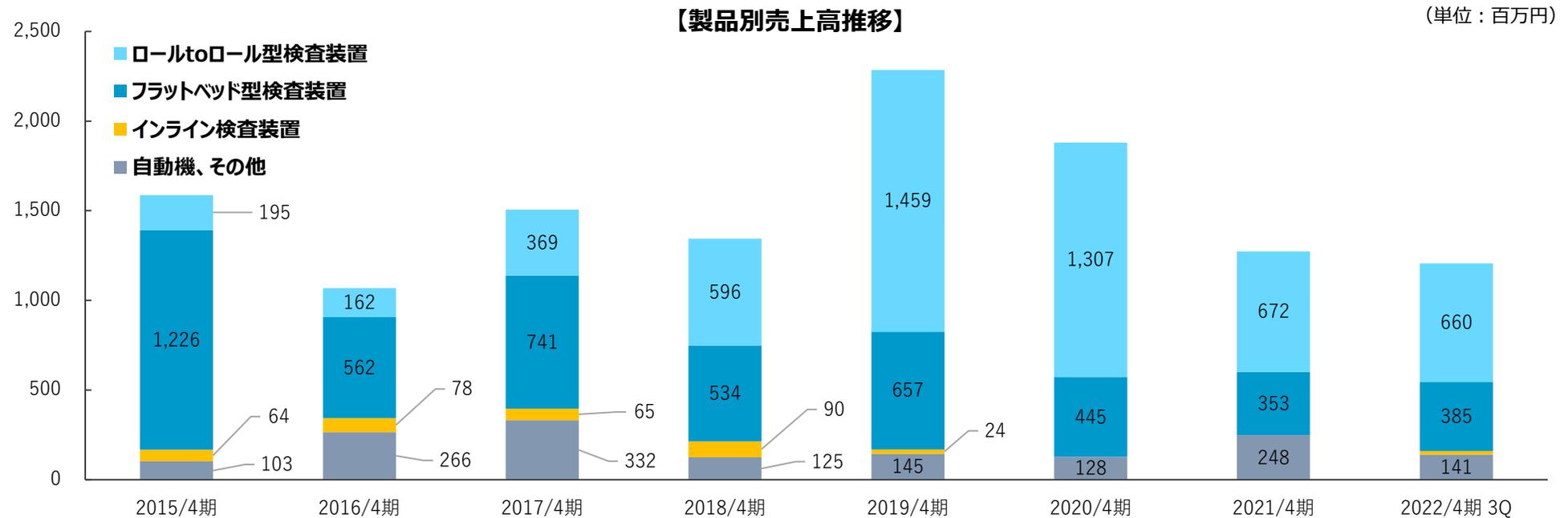
新製品!  
ロールtoロールDI  
RD3000発表



平成18年  
東京証券取引所  
マザーズ市場へ上場  
本社工場増築

# 製品別売上高

	2022年4月期 3Q		2021年4月期 4Q	
	金額 (百万円)	構成比	金額 (百万円)	構成比
■ 売上高合計	<b>1,207</b>	<b>100.0%</b>	1,273	100.0%
■ ロール to ロール型検査装置	<b>660</b>	<b>54.6%</b>	672	52.9%
■ フラットベッド型検査装置	<b>385</b>	<b>31.9%</b>	353	27.7%
■ インライン検査装置	<b>20</b>	<b>1.7%</b>	—	—
■ 自動機・その他	<b>141</b>	<b>11.8%</b>	248	19.4%





**インスペックの成長戦略**

## テクノロジーの大きな転機

機械



第四次産業革命  
超高速次世代通信  
テック産業

ネットワーク & AI & センシング



ものの概念が変わる = パラダイム・シフト

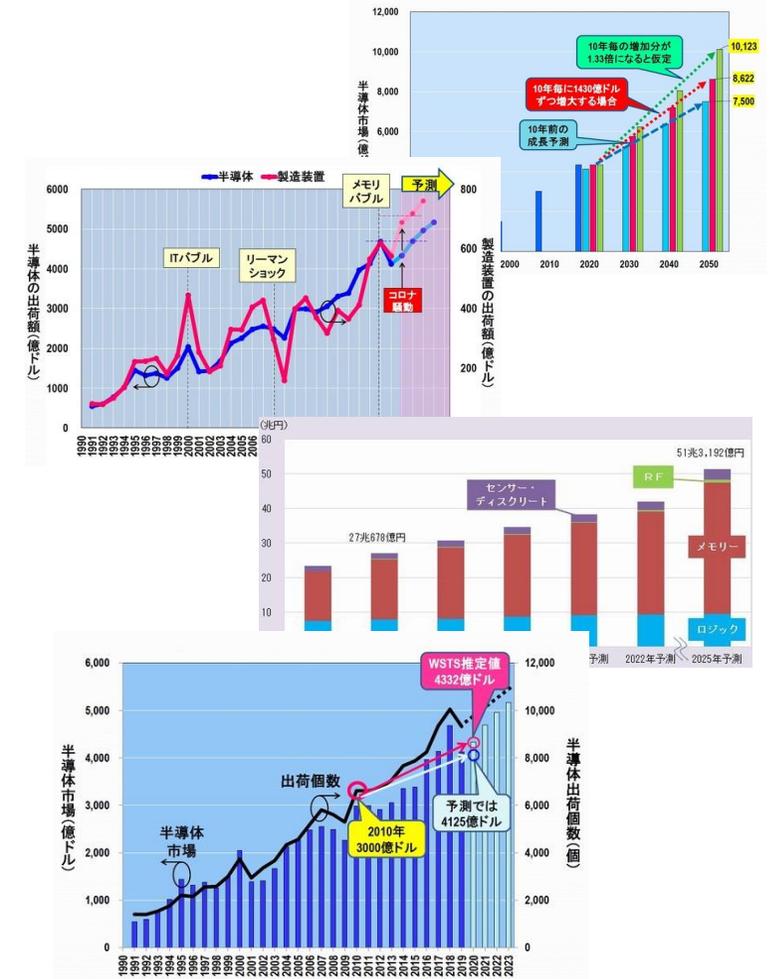


# 拡大を続ける半導体需要

## 広がる半導体の用途



## 成長し続ける市場





SX5600

## 半導体パッケージ基板向けAOI『SX5600』

- インスペック基板AOIのフラッグシップモデル
- 最小線幅9 $\mu$ mの超高精細基板に対応
- クラス最速レベルの生産性を実現

## 半導体パッケージ基板向けAVI『BP7200』

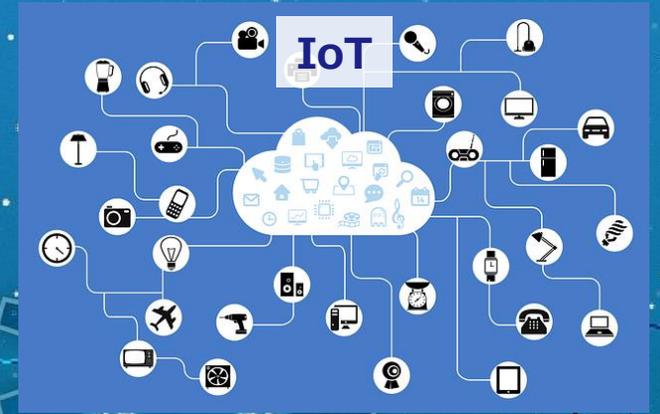
- JEDECTレイをまるごと検査
- 1ピース1.2秒の超高速検査を実現
- CPU向けパッケージ基板で多くの実績



BP7200



Connected CAR



IoT

CASE

IoT

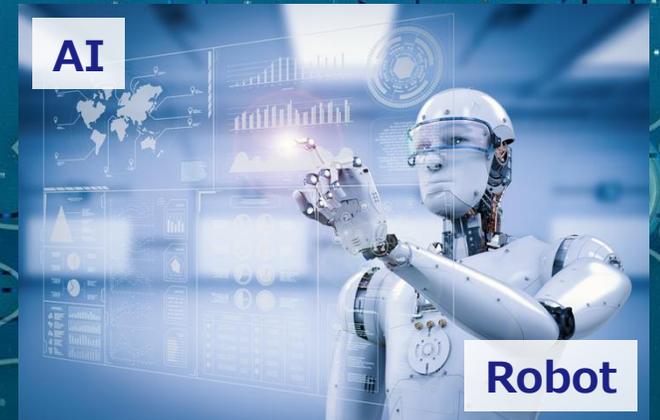
5G

ICT



Industry 4.0

あらゆるものがつながる時代



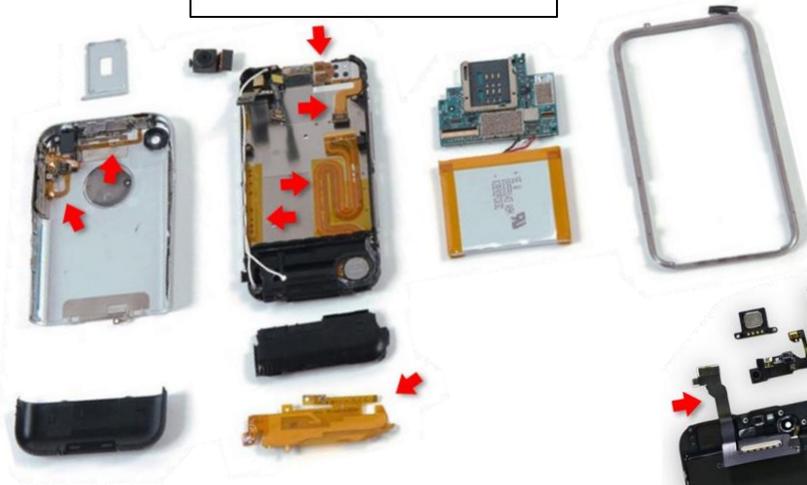
AI

Robot

AI

# スマートフォンに使われているFPC

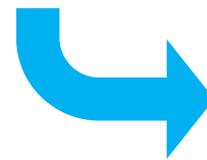
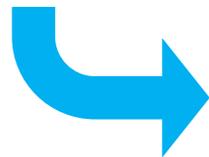
初代 iPhone



iPhone6



iPhone13 Pro





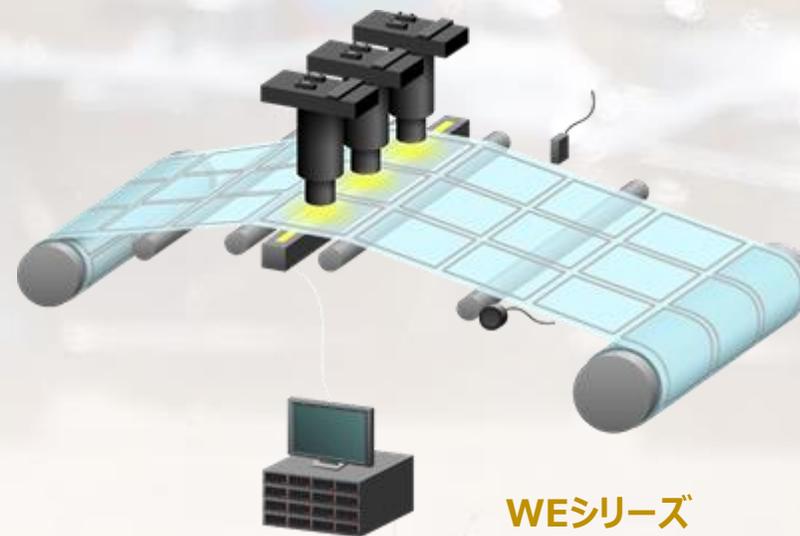
RA7100

## エレクトロニクス分野向けロールtoロールAOI『RA7100』

- スマートフォン、タブレット端末、ウェアラブルデバイスなど小型デジタルデバイスに使用されるFPCの**ファインピッチパターン**向け検査装置
- **業界最速クラスの検査速度**で**圧倒的な生産性**を実現
- 長年培ってきたロールtoロール搬送技術と高性能画像処理システムで**高精細なパターンも安定した検査**が可能

## インライン検査装置『WEシリーズ』

- チップコンデンサ、タッチパネル製造ラインなどお使いの装置に**組み込み可能なインラインAOI**
- 拡大する需要と高まる品質ニーズに柔軟に対応可能

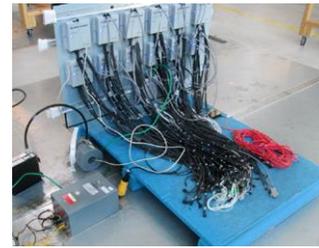


WEシリーズ

# エレクトロニクス分野以外へのFPCの利用拡大

FPCはその**利便性の高さ**から、エレクトロニクスのみならず、**自動車、航空宇宙産業**など、様々な分野で**採用が拡大**しています。FPCへの置き換えにより、**生産性の向上**による**サプライチェーン問題の解消**、**大幅な軽量化**、**内部設計の自由度アップ**など多方面に渡ってメリットが期待できます。

## ➤ 自動車の電子機器配線が一気に増加し、ワイヤーハーネスはFPCへ



バッテリー・マネジメント・システム

## ➤ FPC化が期待される分野



航空機



宇宙産業



## 車載分野向けロールtoロールAOI『RA7400』

- 超高速検査で圧倒的な生産性を実現
- 車載向けのラフピッチなFPCに特化したモデル
- 充実したスペックを低価格で提供



RA7400



RD3000

## ロールtoロール型シームレス直描露光装置『RD3000』

- インспекの戦略的新製品
- 世界初！最長6mのシームレス長尺露光を実現
- 半導体レーザーによりメンテナンスコストを大幅に削減

# インスペックの2大戦略 1.製品カテゴリーの拡大

## 1. エレクトロニクスマーケット

### 事業分野

- 半導体分野
- モバイルデバイス分野

### 対応製品

- 高性能検査装置
- SX・BP・BF各シリーズ
- RA・RV各シリーズ



### 主要マーケット

- 日本国内
- アジア地域

### キーワード

- **5G → 6G**
- **AI**
- **DX**
- **VR・AR・MR**
- **CLOUD**

## 2. モビリティマーケット

### 事業分野

- 車載エレクトロニクス
- 航空機のエレクトロニクス

### 対応製品

- RtoR型検査装置
- RA7400シリーズ
- RtoR型直描露光装置
- RD3000シリーズ

### 主要マーケット

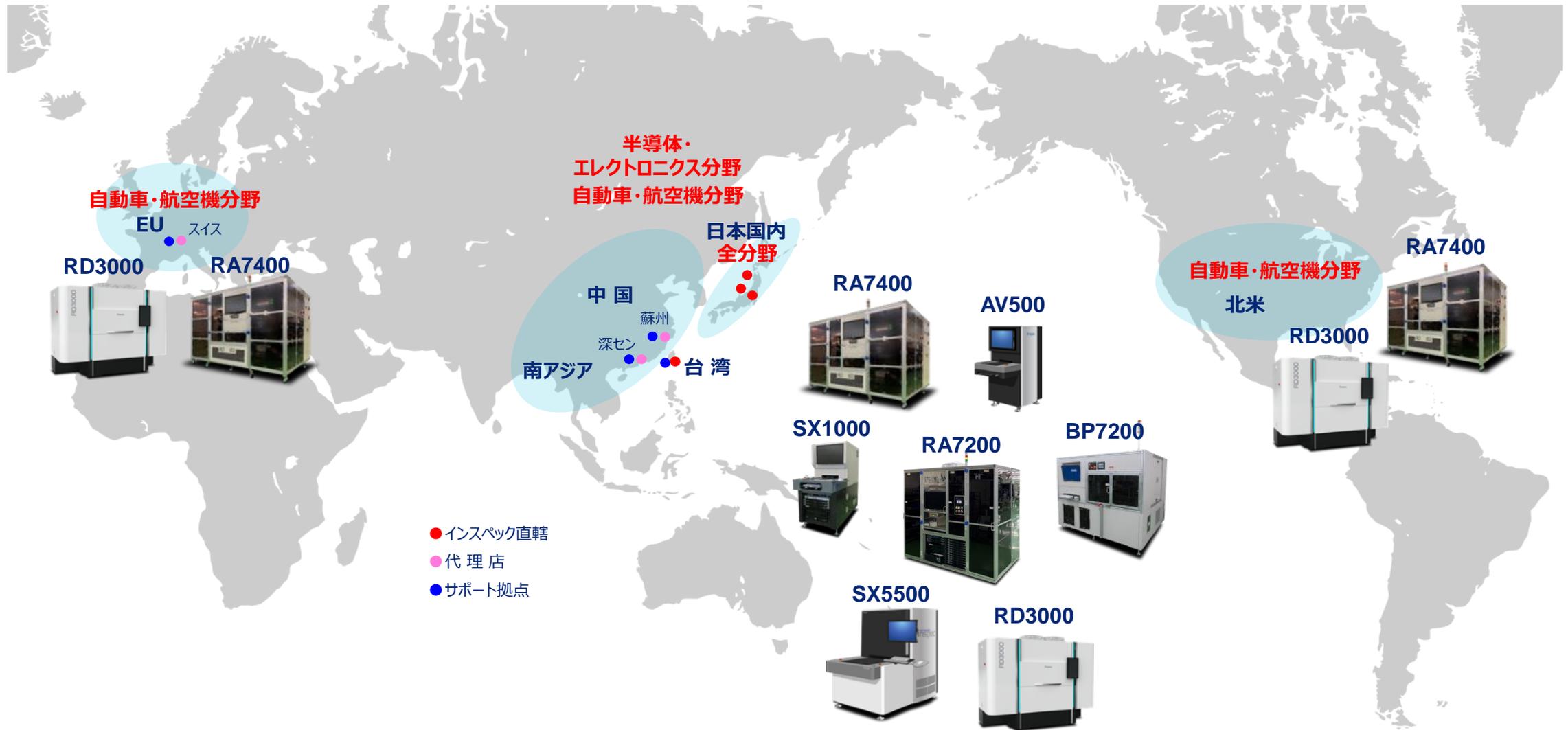
- 欧州
- 北米
- 日本国内
- アジア地域

### キーワード

- **CASE**
- **カーボンニュートラル**
- **車両軽量化**



# インスペックの2大戦略 2.事業エリアの拡大



ファインパターン対応 後継モデル開発中



自動化

高精細化

高速化

2023年  
リリース

RD5000

自動車向け省エネルギー効果を生むワイヤハーネス代替部品の軽量化技術の開発

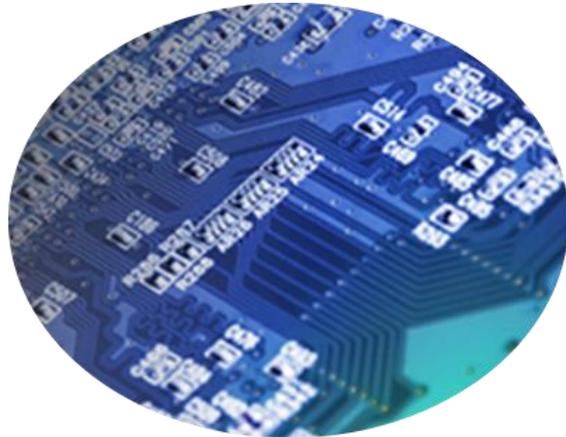
**NEDO (※) 戦略的エネルギー技術革新プログラムに採択**

※NEDO：国立研究開発法人 新エネルギー・産業技術総合開発機構

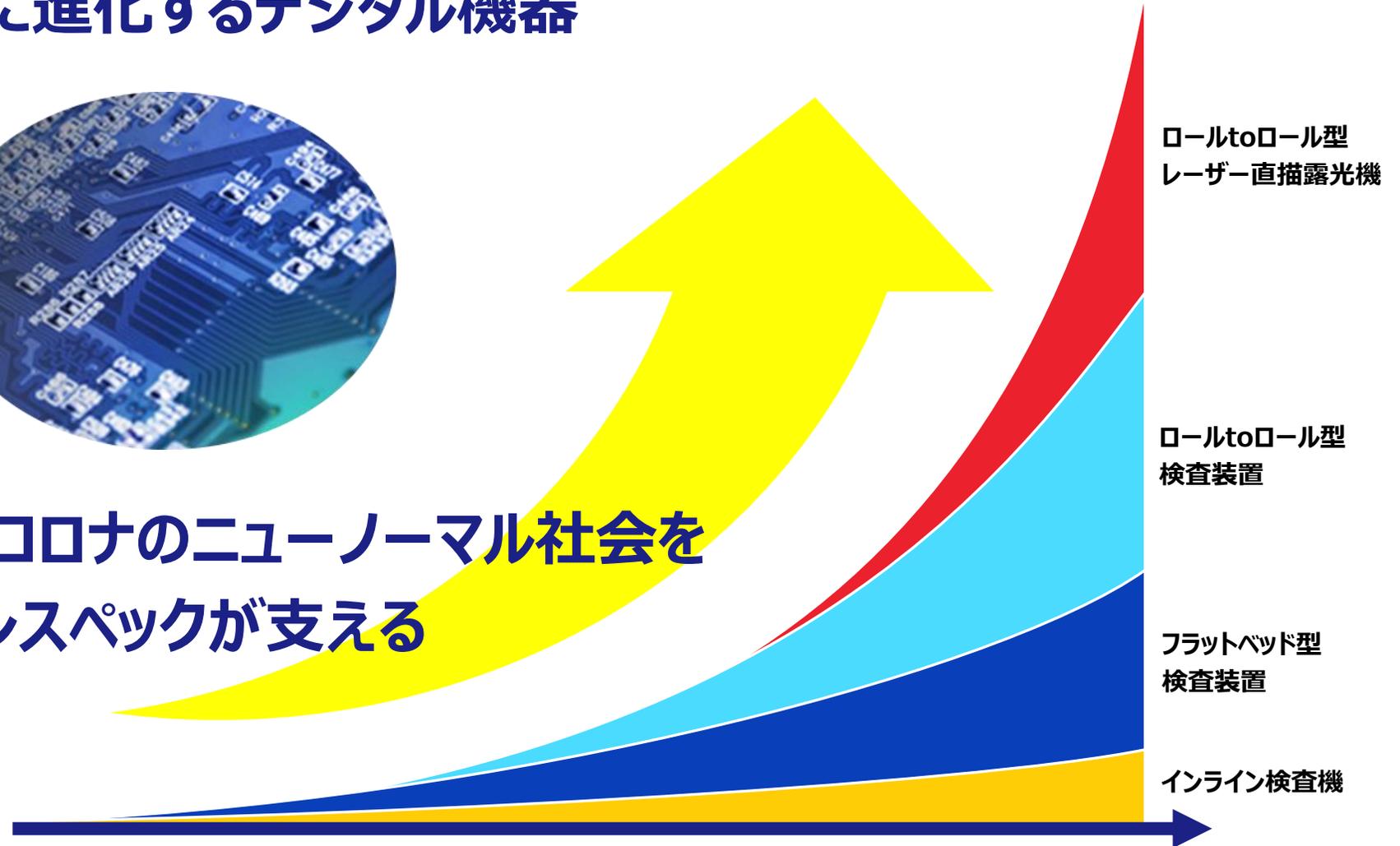
主な仕様

- |               |   |
|---------------|---|
| ○ レーザー光源      | : 波長390nmの個体レーザー                                  |
| ○ 最小L/S       | : 25 $\mu$ m/25 $\mu$ m (目標15 $\mu$ m/15 $\mu$ m) |
| ○ 露光速度        | : 30mm/秒  |
| ○ 最大材料幅 (露光幅) | : 520mm (500mm)                                   |
| ○ アライメント      | : 複数アライメントマークによる歪補正方式                             |
| ○ 個別ID露光      | : 有り (データマトリックス、英数24文字)                           |
| ○ 最大露光長       | : 6m (条件付きで100mも可能)                               |

## 加速度的に進化するデジタル機器



With/Afterコロナのニューノーマル社会を  
インスペックが支える



# 私たちインスペックは「誰一人取り残されない社会」を目指し、 その繁栄と発展に貢献してまいります。



- ✓ NPO法人カタリバへの寄付
- ✓ ガスヒートポンプエアコンの採用
- ✓ 全社の照明をLED化へ
- ✓ 露光機の開発でCO2削減への貢献
- ✓ 地域行事への社員の参加による協賛
- ✓ ゴミ、産業廃棄物の徹底したリサイクル
- ✓ 全社員へ月刊誌『致知』を配布し、毎月社内木鶏会を実施
- ✓ 全社員のWebセミナー受講を継続
- ✓ 自分の頑張りが会社の成長につながる、チャレンジし続けるワクワク感の創出
- ✓ 歴史と伝統の町、角館の景観を維持するボランティア活動

**「社員で取り組むSDGs」**  
**インスペック株式会社が清掃活動**

仙北市に本社を置く半導体検査装置メーカーのインスペック株式会社では今年の1月よりSDGsについて学び、感想や自社の活動についてレポートを提出するなどSDGs活動の目標を達成する取り組みをしています。

10月9日、SDGs目標11「住み続けられるまちづくりを」として角館町の武家屋敷通り周辺の清掃活動を社員や家族32人で行いました。

地元の方や観光客が利用する箇所を重点的に草むしりや落ち葉を集めるなど心地よい汗を流しながら作業をしました。

同社の社員で家族と参加した相馬悠太さんは「美しい景観を維持すると、観光などで訪れた方々はよい思い出を持ち帰ることができる。また、自分たちが掃除をすることで一層地元愛を深められるという相乗効果も生まれる」と話しました。

また、社員である父親が清掃活動をすると聞いて自主参加を希望した小学生もいました。感想を伺うと「最初は落ち葉が散らかっていたけどきれいになっ

てよかった。きれいになったことで皆さんに好印象をもってもらいたい」と元氣よく話してくれました。

本活動で委員長を務めている富岡善榮子さんは「この活動で終わることはなく、地域の関わりを大事にさらに続けていきたい」と話しました。

誰一人取り残さない持続可能な社会の実現に向け今すぐできることとして、使用済み切手の収集やペットボトルのキャップ集めなど、SDGsへの取り組みが続きます。



清掃活動を通して地域との関わりが深まりました。

仙北市広報11月号

**ご清聴ありがとうございました。**

**インスペックは、世界におけるオンリーワン企業を  
目指し、チャレンジを続けてまいります。**



# Appendix

- 用語集
- 2022年4月期第3四半期決算概要

リードフレーム	ICやLSIなどの半導体パッケージに使われ、半導体素子（半導体チップを支持固定し、外部配線）を接続する基板。
FPC（Flexible Printed Circuits）	フレキシブルプリント回路基板、フレキシブルプリント配線板と呼ばれ、絶縁性を持った薄く柔軟なベースフィルムと、銅箔等の導電性金属を貼り合わせた基材に電気回路を形成した基板。
TAB（Tape Automated Bonding）テープ	半導体業界では、半導体集積回路に接合されるテープ状のフレキシブル回路基板を指す。
COF（Chip On Film）	フィルム状の配線回路基板の上に半導体チップ（ドライブIC）を実装する技術のこと。
AOI（Automated Optical Inspection）	自動光学検査装置、パターン検査装置。
AVI（Automated Final Visual Inspection）	自動最終外観検査装置。
ロールtoロール	電子デバイスを効率よく量産する手法の一つ。ロール状に巻いた長さ数十～数百メートル、巾数十センチメートル程度のフィルム状の材料に基板の回路パターンを印刷し、封止膜などと張り合わせてから再びロールに巻き取る。従来方式では個別に切り離された基板を使うため、ある工程から次の工程に個々の基板を搬送する手間が掛かる。
ベリファイ装置	Verify：実証する、確認するという意味。検査装置本体で欠陥（不良品）として判断された基板でも、実際はごみの付着による誤検出などで、ごみを取り除けば良品になることから、検査プロセスの中で、検査装置での検査した後にベリファイ装置を使用する機会が多い。
インライン	生産工場において、検査装置を製造ラインの中に組み込むことをいう。
IoT（Internet of Things）	モノのインターネット。様々なモノ（物）がインターネットに接続される仕組みをいう。
CASE	自動車産業に大きな変革をもたらす4つの要素。Connected（コネクテッド）、Autonomous（自動運転）、Shared（シェアリング）、Electric（電動化）。
LDI,DI（レーザー直描露光機）	プリント基板制作において基板上に塗布された感光材にレーザー光で直接描画する露光装置。

# 要約貸借対照表

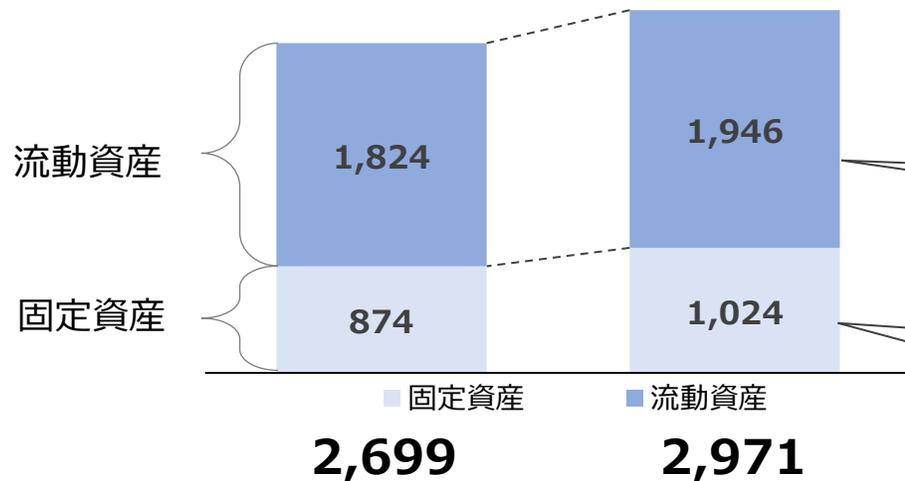
(単位：百万円)

2021年4月期  
2,699

2022年4月期3Q  
2,971

	2021年4月期	2022年4月期3Q
自己資本	756百万円	<b>692百万円</b>
自己資本比率	28.0%	<b>23.3%</b>

資産の部

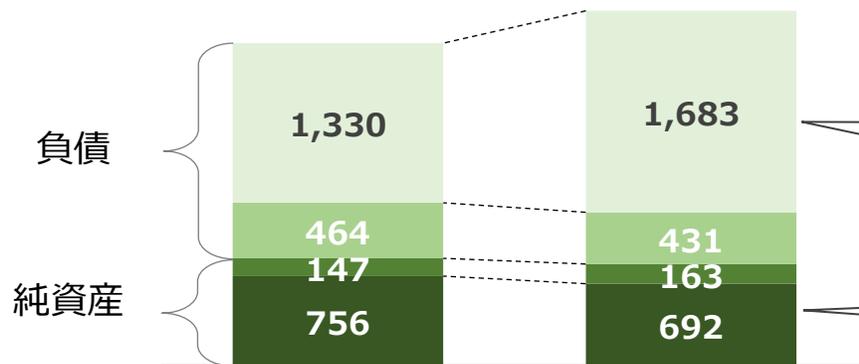


【主な増減要因】

原材料及び貯蔵品：63百万円増加

建設仮勘定：111百万円増加  
→主に直描露光機のデモ機製作

負債の部、純資産の部



短期借入金：500百万円増加  
支払手形及び買掛金：99百万円減少

四半期純損失：67百万円計上

■ 自己資本 ■ 新株予約権 ■ その他の負債 ■ 有利子負債

# 研究開発費

	2022年4月期 3Q		2021年4月期 3Q		対前年 増減率
	金額（百万円）	対売上比	金額（百万円）	対売上比	
半導体パッケージ基板・ 精密基板検査装置関連事業、 ロールtoロール型シームレス直描露光機事業	175	14.5%	130	13.1%	+34.7%

## ◆半導体パッケージ基板・精密基板検査装置関連事業

- ・ロール to ロール向け画像処理システム、高速インライン検査システム等の開発
- ・AIを活用した欠陥分類システムの開発

## ◆直描露光機事業

- ・ロール to ロール型シームレスレーザー直描露光機の開発（次世代機）

## 本資料のお取り扱い上のご注意

**本資料は当社をご理解いただくために作成されたもので、当社への投資勧誘を目的としたものではありません。**

**本資料を作成するに当たっては、正確性を期すために慎重に行っておりますが、完全性を保証するものではありません。本資料中の情報によって生じた障害や損害については、当社は一切責任を負いません。**

**本資料中の業績予想ならびに将来予測は、本資料作成時点で入手可能な情報に基づき当社が判断したものであり、潜在的なリスクや不確実性が含まれています。そのため事業環境の変化等の様々な要因により、実際の業績は言及又は記述されている将来見通しとは大きく異なる結果となることをご承知おきください。**